

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: **Kensaku SHINOZAKI**

Serial Number: **Not Yet Assigned**

Filed: **February 11, 2004**

For: **COPPER FOIL FOR HIGH FREQUENCY CIRCUIT AND METHOD
OF PRODUCTION OF SAME**

Attorney Docket No. 042100
Customer No.: 38834

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

February 11, 2004

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application is hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japanese Appln. No. 2003-033159, filed on February 12, 2003

In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicant has complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copy.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 50-2866.

Respectfully submitted,
WESTERMAN, HATTORI, DANIELS & ADRIAN, LLP


Stephen G. Adrian
Reg. No. 32,878

1250 Connecticut Avenue, N.W., Suite 700
Washington, D.C. 20036
Tel: (202) 822-1100
Fax: (202) 822-1111
SGA/yap

03/8103 U.S

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 2月 12日

出願番号 Application Number: 特願 2003-033159

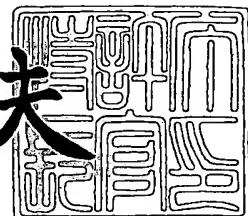
[ST. 10/C]: [JP 2003-033159]

出願人 Applicant(s): 古河テクノリサーチ株式会社
古河サーキットフォイル株式会社

2004年 1月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫



出証番号 出証特 2003-3109656

【書類名】 特許願

【整理番号】 FCFSI-01

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B32B 15/01

C25D 01/04

【発明者】

【住所又は居所】 栃木県今市市荊沢601番地の2 古河サーキットフォイル株式会社内

【氏名】 篠崎 健作

【特許出願人】

【識別番号】 300062979

【氏名又は名称】 古河テクノリサーチ株式会社

【代表者】 御館 守

【電話番号】 045-320-4460

【特許出願人】

【識別番号】 591056710

【氏名又は名称】 古河サーキットフォイル株式会社

【代表者】 久守 猛

【電話番号】 0288-22-4911

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 112082

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 高周波用途対応可能銅箔とその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 電解銅箔において、該銅箔の表面の一部がコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の凹凸面であることを特徴とする電解銅箔

【請求項 2】 樹脂基板との被接着面のコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ である未処理銅箔の該被接着面上に電気分解浴中で所定電流を所定時間付加する粗化処理を施してなることを特徴とする請求項 1 に記載の電解銅箔。

【請求項 3】 前記粗化処理はモリブデン、コバルト、ニッケル、鉄、タンゲステン、砒素の少なくとも 1 種を含有する酸性電気分解浴で電気分解で行うことと特徴とする請求項 2 に記載の電解銅箔。

【請求項 4】 前記粗化処理後、粗化処理表面上に、更に銅めっき層が施されていることを特徴とする請求項 2 又は 3 に記載の電解銅箔。

【請求項 5】 前記粗化処理後、粗化処理表面上に銅めっきを施し、その上にニッケルめっき、亜鉛めっき、コバルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理の少なくとも一つ以上の層を設け、その上に必要によりカップリング剤処理を施してなることを特徴とする請求項 2 又は 3 に記載の電解銅箔。

【請求項 6】 樹脂基板との被接着面のコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ である未処理銅箔の被接着表面上にニッケルめっき、亜鉛めっき、コバルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理の少なくとも一つ以上の層を設け、更にその上に必要によりカップリング剤処理層を設けたことを特徴とする請求項 1 に記載の電解銅箔。

【請求項 7】 銅を主成分とし、メルカプト基を持つ化合物並びにそれ以外の少なくとも 1 種以上の有機化合物及び塩化物イオンを添加した電気分解液を用いて電気分解し、表面の一部がコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の凹凸面を有する銅箔とすることを特徴とする電解銅箔の製造方法。

【請求項 8】 メルカプト基を持つ化合物並びにそれ以外の少なくとも 1 種以上の有機化合物及び塩化物イオンを添加した電気分解液を用いて被接着面の表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の電解銅箔を製造し、該電解銅箔の被接着面上に電解浴中で

所定電流を所定時間付加する粗化処理を施すことを特徴とする電解銅箔の製造方法。

【請求項 9】 粗化処理を施す電解浴はモリブデン、コバルト、ニッケル、鉄、タンゲステン、砒素の少なくとも 1 種を含有する酸性電気分解浴であることを特徴とする請求項 7 に記載の電解銅箔の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は被接着面の表面粗度が小さく、特に高周波用プリント回路の導電材として適した電解銅箔及びその製造方法に関するものである。

本発明の主用途は高周波用プリント回路の導電材であるが、本発明による電解銅箔はこの用途に限定されるものではない。

【0002】

【従来の技術】

プリント回路用の導電材としての電解銅箔は、樹脂基板に接合させる樹脂基板接着面（以下被接着面という）の接着強度、電気特性、エッチング性、耐熱性等を満足しなければならない。これらの特性を満足させるために、銅箔の被接着面を粗化させ、さらにその化学的性質を改善する処理方法が種々提案され、実施されている。

【0003】

一例として酸性銅電気分解浴中で銅箔を陰極とし、限界電流密度付近で電気分解を行いやけめっきを施し粗面を得る方法が提案されている（例えば特許文献 1 参照）。また、粗化面の微細な表面を通常の銅めっきで覆って突起群を銅箔面により安定に固着する方法が提案されている（例えば特許文献 2 参照）。

【0004】

【特許文献 1】

特公昭 40-15327 号公報

【特許文献 2】

米国特許第 3293109 号明細書

【0005】

ところで近年、携帯電話等のモバイル機器が急速に普及し、これに伴い携帯電話用の基地局やスーパーコンピューター用に、高周波特性に優れた銅箔が要求されてきている。

高周波は表皮作用を持ち、導体に交流を流すと磁束変化のために導体の中心部に起電力が生じ、電流が流れ難くなる。この現象は交流の周波数が高くなるほど著しくなり、殆ど表面にしか電流が流れなくなる。このことから高周波数帯では銅箔の光沢面と被接着面にのみ電流が流れることとなる。このため、銅箔の光沢面と被接着面の粗度 (R_z) が大きいと信号の伝送距離が長くなり、信号の減衰や遅延等の問題が生じてくる、と考えられ、高周波用プリント回路の導電材向けの銅箔にはロープロファイル銅箔が適していると考えられていた。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、本発明者は高周波特性に優れた銅箔の要求に応じるために様々な実験を行った結果、上記理論と異なる結果を得た。

表1は被接着面の表面粗さを種々変えた銅箔に 3 GHz の高周波を伝送した時の伝送損失を示すもので、この表1より被接着面粗度の伝送損失への影響は極めて小さいことが実証された。

【0007】

表1

粗化処理条件 (粗化電流／粗化速度(A・分/m))	原箔の粗度 (μm)	粗化処理後の 粗度(μm)	接着強度	3GHz 伝送損失 (dB/m)
400	1. 70	1. 99	0. 74	3. 97
400	1. 12	1. 33	0. 61	3. 98
1000	1. 60	3. 77	1. 00	4. 03
1000	1. 20	1. 72	0. 74	4. 01
300	4. 74	5. 14	0. 92	3. 92

【0008】

そこで、伝送損失に与える因子につき更に検討した結果、被接着面に銅粒子を析出させるために行う粗化処理の強さ（ここで粗化処理の強さとは、粗化電流を粗化速度で割ったA・分/mの値と定義する）が大きく影響していることを突き止めた。

即ち、従来の技術では、充分な接着強度を得るために粗化処理を強く（粗化電流を大きく、又は粗化時間を長く）する必要があり、それを行うことにより伝送損失を悪化させていたのである。

そこで、伝送損失を向上させるために粗化処理を弱く（粗化電流を小さく、又は粗化時間を短く）することが考えられるが、粗化処理を弱くすると充分な接着強度が得られないといった問題が新たに発生する。表2は粗化処理の強さと接着強度、伝送損失を、原銅箔と同じにして測定した結果で、粗化処理が強いと接着強度は向上するが伝送損失にも影響し、粗化処理が弱いと伝送損失は向上するが接着強度は低下する傾向を示す。

【0009】

表2

粗化処理 (粗化 電流／粗化速度 (A・分/m)	原箔の粗度 (μ)	表面処理後 の粗度 (μ)	接着強度	3GHz 伝送損 失(dB/m)
2600	0.83	2.30	1.07	4.38
2000	0.83	1.80	0.95	4.06
1600	0.83	1.60	0.87	4.00
1300	0.83	1.25	0.80	3.83

【0010】

この傾向は殆どの箔種で同様であり、被接着面の粗度が粗い原箔を用いた場合も同様であった。つまり被接着面の粗度が大きい原箔を使用しても高伝送特性と高接着強度の両立を実現することはできなかった。

なお、伝送損失の値は測定環境に大きく影響されるため、測定値を比較するた

め本明細書では同一環境下で測定した、従って、表1、表2、またその他の値の比較が可能である。

【0011】

ところで、メルカプト基を持つ化合物並びにそれ以外の少なくとも1種以上の有機化合物及び塩化物イオンを添加した銅の電気分解液を用いて銅箔を製造する発明が開示されている（特許文献3参照）。この発明で製造される銅箔は被接着面側も光沢を有し、非常に平滑であり、この銅箔にやけめっき等の処理を行うことにより被接着面が非常に低粗度でファインパターンに適した銅箔の作成が可能となっている。

【0012】

【特許文献3】

特許第3313277号公報

【0013】

従って、従来の理論では光沢面及び被接着面の粗度が小さければ伝送損失が良好であると考えられていることから、ここに開示されている技術で得られる両面光沢箔は非常に優れた伝送損失特性を有することが期待される。しかしながら、この銅箔は接着強度を得るために強い粗化処理を施さなければならず（接着面の粗度は小さいが粗化処理は強い）、その結果、伝送損失は非常に悪くなってしまっていた。その原因は、表1及び表2に示した実験結果のように伝送損失は表面粗度よりも粗化処理の強さに依存するためである。

【0014】

本発明はかかる知見に基づき、近年のプリント配線板の要求に応えるだけの高接着強度を有し、高周波伝送特性に優れた電解銅箔、並びにその製造方法を提供することを目的とする。

本発明の銅箔は高接着強度を有し、被接着面の粗度が小さいファインパターン対応銅箔としての適用も可能であり、特に、本発明電解銅箔を用いることで高周波伝送損失が改善された優れたファインパターンプリント配線基板を提供することができるものである。

【0015】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1は、電解銅箔において、該銅箔の表面の一部がコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の凹凸面であることを特徴とする電解銅箔である。

【0016】

本発明の請求項2は、樹脂基板との被接着面の表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ である未処理銅箔の該被接着面上に電気分解浴中で所定電流を所定時間付加する粗化処理を施してなることを特徴とする請求項1に記載の電解銅箔である。

【0017】

本発明の請求項3は、前記粗化処理はモリブデン、コバルト、ニッケル、鉄、タングステン、砒素の少なくとも1種を含有する酸性電気分解浴で電気分解を行うことを特徴とする請求項2に記載の電解銅箔である。

【0018】

本発明の請求項4は、前記粗化処理後、粗化処理表面上に、更に銅めっき層が施されていることを特徴とする請求項2又は3に記載の電解銅箔である。

【0019】

本発明の請求項5は、前記粗化処理後、粗化処理表面上に銅めっきを施し、その上にニッケルめっき、亜鉛めっき、コバルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理の少なくとも一つ以上の層を設け、その上に必要によりカップリング剤処理を施してなることを特徴とする請求項2又は3に記載の電解銅箔である。

【0020】

本発明の請求項6は、樹脂基板との被接着面のコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ である未処理銅箔の被接着表面上にニッケルめっき、亜鉛めっき、コバルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理の少なくとも一つ以上の層を設け、更にその上に必要によりカップリング剤処理層を設けたことを特徴とする請求項1に記載の電解銅箔である。

【0021】

本発明の請求項7は、銅を主成分とし、メルカプト基を持つ化合物並びにそれ以外の少なくとも1種以上の有機化合物及び塩化物イオンを添加した電気分解液

を用いて電気分解し、表面の一部がコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の凹凸面を有する銅箔とすることを特徴とする電解銅箔の製造方法。

【0022】

本発明の請求項8は、メルカプト基を持つ化合物並びにそれ以外の少なくとも1種以上の有機化合物及び塩化物イオンを添加した電気分解液を用いて被接着面の表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の電解銅箔を製造し、該電解銅箔の被接着面上に電解浴中で所定電流を所定時間付加する粗化処理を施すことを特徴とする電解銅箔の製造方法である。

【0023】

本発明の請求項9は、粗化処理を施す電解浴はモリブデン、コバルト、ニッケル、鉄、タンクステン、砒素の少なくとも1種を含有する酸性電気分解浴であることを特徴とする請求項7に記載の電解銅箔の製造方法である。

【0024】

本発明の電解銅箔は、その表面の一部がコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の凹凸面であることを特徴とする。かかる電解銅箔は、メルカプト基を持つ化合物並びにそれ以外の少なくとも1種以上の有機化合物及び塩化物イオンを添加した電解液を用いた電気分解で作成する。このようにして作成した銅箔の樹脂基板と接着する面（被接着面）の表面粗度は $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の平滑な面に仕上がり、かつ、平滑な被接着面の一部にはコブ状の突起ができており、高周波伝送損失が良好な銅箔として提供することができる。

【0025】

しかし、上記電解銅箔は接着強度に欠け、使用用途によってはより強い接着強度を要求される。その要求を満足するためには、上記電解銅箔を未処理銅箔（原箔）として、該未処理銅箔の被接着面上に、電気分解浴中で所定電流を所定時間付加する粗化処理を施す。未処理原箔へ施す粗化処理は従来の粗化処理よりも弱い処理条件で施す。弱い粗化処理を施すことにより、従来と同等又はそれ以上の接着強度を有し、（接着面の粗度は大きいが粗化処理は弱い）、高周波伝送損失が良好な銅箔を提供することができる。

【0026】

また、この粗化処理する粗化電解浴にはモリブデン、コバルト、ニッケル、鉄、タンゲステン、砒素の少なくとも1種を含有する酸性電解浴が使用可能である。なお、この粗化処理を行った銅箔上にニッケルめっき、亜鉛めっき、コバルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理及びカップリング剤処理の少なくとも一つを施すことにより、耐熱性・耐HCl性・防錆力・接着強度の向上を行うことが可能である。

【0027】

また、未処理銅箔上にニッケルめっき、亜鉛めっき、コバルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理およびカップリング剤処理の少なくとも1つを施すことにより、粗化処理を施した銅箔よりも表面粗度が小さく、ある種の基材に対して高接着強度を有することを特徴とする銅箔の作成が可能である。又これらのめっき及びカップリング剤処理を行うことにより耐熱性・耐HCl性・防錆力の向上を行うことが可能である。

【0028】

次に、電解銅箔の製造条件及びこの電解銅箔を未処理銅箔として表面処理を行った場合の実施例を示す。但し、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

実施例 1

(1) 電解銅箔製箔条件及び液組成

本発明を実施する電解銅箔製箔条件として表3 A～C（以下実施例A～Cと云う）に示す電解液組成・電解条件で電解銅箔を製作し、また、比較例として表3のDに示す電解液組成・電解条件で未処理銅箔を製作した。

【0029】

表3 銅箔製箔条件及び液組成

条件	銅	硫酸	M P S	H E C	膠	C 1	電流密度	液温
A	90g/l	80g/l	0.8ppm	5ppm		40ppm	60A/dm2	60°C
B	90g/l	80g/l	1ppm	5.5ppm		40ppm	60A/dm2	60°C
C	90g/l	80g/l	1ppm	4ppm	2ppm	40ppm	60A/dm2	60°C
D	90g/l	80g/l	1ppm	3ppm	6ppm	40ppm	60A/dm2	60°C

注) M P S : メルカプトプロパノールスルフォン酸

H E C : ヒドロキシエチルセルロース

【0030】

製作した電解銅箔の性能を表4に、表面状態を図1乃至図3に示す。

表4 銅箔性能

条件	箔 厚	光沢面粗度	被接着面粗度
A	35 μm	1.5 μ	3.5 μ
B	35 μm	1.5 μ	3.6 μ
C	35 μm	1.5 μ	2.4 μ
D	35 μm	1.5 μ	0.8 μ

図1は製箔条件Aで作成したもので、コブ状突起が平均的に分散されている。

図2は製箔条件Bで作成したもので、コブ状突起が緻密に密集している。図3は製箔条件Cで作成したもので、コブ状突起が小さく図1に比較して隙間を大きくして平均的に分散されている。

【0031】

(2) 粗化処理条件及び粗化液組成

上記で製作した電解銅箔A～Dの表面に表5に示す粗化液組成で粗化処理を施した。

表5 粗化液組成

	銅	硫酸	M o	N i	F e	W	A s	C o
1	25g/l	160g/l	350ppm		4.0g/l	0.2ppm		
2	25g/l	160g/l	50ppm		8.0g/l	0.4ppm		
3	25g/l	160g/l	250ppm	2.0g/l				
4	25g/l	160g/l	250ppm					2.0g/l
5	25g/l	160g/l	350ppm		4.0g/l			
6	25g/l	160g/l					350ppm	

【0032】

粗化処理は、

粗化電流密度：5～30A/dm²、

処理時間：2～15秒、

温度：20～40℃

とし、本発明の実施例における粗化電流密度：5～30A/dm²は従来実施されている粗化処理電流密度よりも低くい条件である。なお、処理時間を2～15秒としたのは、アノードの大きさを変えて処理したためで、各液組成においてラインスピードは一定である。

【0033】

粗化処理後の銅箔表面に表6に示す条件でカプセルめっきを施した。

表6 カプセルめっき液条件

銅	硫酸	液温	電流密度	処理時間
65g/l	100g/l	50℃	10～60A/dm ²	2～15秒

本発明においては、粗化処理、カプセルめっき処理を複数回行う場合がある。

【0034】

(3) 粗化処理後の性能（同一処理条件による処理）

粗化処理し、カプセルめっきを施した処理銅箔の性能を表7に示す。

表7

未処理銅箔	粗化液組成	原 箔 Rz	粗化後 Rz	F R - 4との接着強度
A	1	3.5	4.9	1.54 kgf/cm ²
A	2	3.5	5.2	1.53 kgf/cm ²
A	3	3.5	6.2	1.50 kgf/cm ²
A	4	3.5	6.4	1.51 kgf/cm ²
A	5	3.5	7.1	1.62 kgf/cm ²
A	6	3.5	7.1	1.51 kgf/cm ²
C	1	2.4	4.0	1.52 kgf/cm ²
C	2	2.4	4.2	1.50 kgf/cm ²
C	3	2.4	5.1	1.47 kgf/cm ²
C	4	2.4	5.5	1.48 kgf/cm ²
C	5	2.4	6.0	1.60 kgf/cm ²
C	6	2.4	6.3	1.51 kgf/cm ²
D	1	0.8	1.1	0.60 kgf/cm ²
D	6	0.8	1.3	0.54 kgf/cm ²

【0035】

この表から明らかなように、未処理銅箔の相違、即ち、実施例A、Cと比較例DとではF R - 4との接着強度が著しく相違することが分かる。本発明は未処理銅箔の表面粗度が2~4 μmのもので、箔表面の一部にコブ状の突起を有する箔であり、その効果は顕著である。

なお、作成した未処理銅箔AとBとは表4に示すようにほとんど同一の性能を示したためAのみにつき粗化処理を施し、Bについては粗化処理を省略した。

なお、銅箔のめっき表面にニッケルめっき、亜鉛めっき、コバルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理およびカップリング剤の少なくとも一つを施すことにより、耐熱性・耐HC1性・防錆力・接着強度が向上する。

【0036】

(4) 伝送損失及びピール値比較

本発明の実施例C箔と比較例D箔とにつき、粗化電流／粗化速度を種々変化させて高周波伝送損失と接着強度（ピール値）を測定した。その結果を表8に示す。

表8

粗化電流／粗化速度	実施例C	実施例C	実施例C	比較例D	比較例D	比較例D
	表面粗度	接着強度	伝送損失	表面粗度	接着強度	伝送損失
2600	7.20	1.57	4.45	2.40	1.07	4.38
900	3.95	1.42	3.79	1.25	0.77	3.77
400	2.90	1.22	3.7	0.90	0.60	3.71
200	2.55	1.21	3.62	0.90	0.59	3.64

【0037】

表8で明らかなように、粗化電流／粗化速度の条件を種々変えて実施例Cの未処理銅箔と比較例Dの未処理銅箔とでは伝送損失の差はほとんど認められない。前述したように伝送損失は処理電流／粗化速度（電流密度、ライインスピード）に依存すると考えられ、未処理銅箔がC又はDのどちらであっても処理電流／粗化速度を同じとすれば伝送損失には差が出ないことがこの実施例で実証されている。

一方、接着強度については、表8から明らかなように、比較例Dの未処理銅箔は粗化処理／粗化速度が小さくなると接着強度が低下し使用出来なくなるが、本発明実施例Cの銅箔は粗化処理／粗化速度が小さくなても高接着強度を保ち、なおかつ未処理銅箔Dと同等の伝送損失特性を保っている。

【0038】

上述したように、比較例Dにおいては粗化処理を弱くすることにより明らかに接着強度の低下が見られた。本発明による実施例Cでは粗化処理を弱くすることにより若干の接着強度の低下は見られたが、比較例Dと比較すると十分な接着強度を有している。

また、伝送損失は比較例Dとほとんど変わらない値である。このことから本発

明を用いることにより伝送損失が良好であり、なおかつ高接着強度を有する銅箔、及びその製造が可能である。

なお、本発明で作成した銅箔は表面粗度が小さく、高接着強度を有するため高周波用途以外のプリント回路用銅箔としても非常に適していることは勿論である。

【0039】

実施例2

(1) 未処理銅箔製箔条件・表面めっき種類及び付着量 (mg/dm²)

実施例1の実施例Cと比較例Dの未処理銅箔製箔条件及び液組成で箔厚3.5 μmの未処理銅箔を製作し、表9に示す表面処理を行った。

表9

条件 No.	Ni	Zn	Cr	Co	Si
1	0.30	0.02	0.03	0	0.005
2	0.30	0.20	0.03	0.2	0.005
3	0.05	0.02	0.03	0	0.005
4	0.05	0.25	0.03	0	0.005
5	0.10	0.04	0.03	0	0.005
6	0.25	0.03	0.03	0.15	0.005
7	0.10	0.03	0.03	0	0

【0040】

(2) 性能

表9で表面処理した銅箔の処理後のR_zとポリイミド基材との接着強度を表10に示す。

表10

	C	C	D	D
条件 No.	処理後 Rz (処理面側)	ポリイミド基材接 着強度	処理後 Rz (処理面側)	ポリイミド基材接着 強度
1	2. 4	1. 78 kgf/cm ²	0. 8	1. 40 kgf/cm ²
2	2. 4	0. 40	0. 8	0. 25
3	2. 4	1. 13	0. 8	0. 82
4	2. 4	0. 33	0. 8	0. 24
5	2. 4	1. 69	0. 8	1. 38
6	2. 4	1. 83	0. 8	1. 43
7	2. 4	0. 80	0. 8	0. 55

この表10に示されるように、未処理銅箔上にニッケルめっき、亜鉛めっき、コバルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理及びカップリング剤処理を施すことにより耐熱性・耐HC1性・防錆力が向上する。

【0041】

一方、上記条件で表面処理した銅箔の伝送損失 (dB/m) を3GHzで測定した結果を表11に示す。

表11

条件NO.	未処理銅箔C	未処理銅箔D
1	3. 58	3. 60
2	3. 56	3. 60
3	3. 56	3. 55
4	3. 57	3. 58
5	3. 60	3. 58
6	3. 60	3. 58
7	3. 58	3. 57

表11から明らかなように、未処理銅箔上にニッケルめっき、亜鉛めっき、コ

バルトめっき、それらの合金めっき、クロメート処理及びカップリング剤処理を施こしても、伝送損失は実施例C、比較例D共に大きく変化することはなかった。

このように、本発明の条件で製造した未処理銅箔を用いることにより従来技術で製箔した銅箔よりも伝送特性を損なうことなく高接着強度を有する銅箔を提供することができる。

【0042】

【発明の効果】

上述したように、本発明の銅箔は表面粗度を若干高めにして樹脂基材との接着強度を高接着強度とし、しかも高周波特性を損なわない優れた銅箔を提供することができる優れた効果を有するものである。従って、使用用途により表面粗度よりも高接着強度を必要とする場合においては非常に有効であり、高周波用途にも非常に適した銅箔である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示す銅箔表面の電子顕微鏡写真である。

【図2】本発明の第二の実施形態を示す銅箔表面の電子顕微鏡写真である。

【図3】本発明の第三の実施形態を示す銅箔表面の電子顕微鏡写真である。

【書類名】 図面

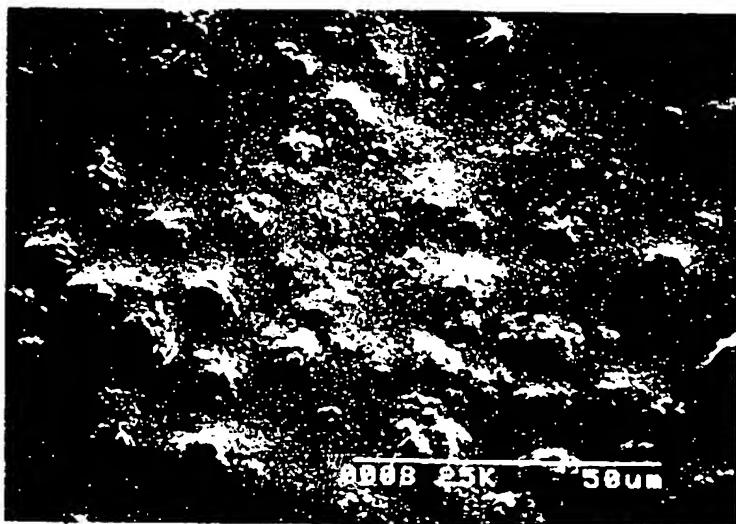
【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 近年のプリント配線板の要求に応えるだけの高接着強度を有し、被接着面の粗度が小さいファインパターン対応銅箔としての適用も可能であり、特に、高周波伝送特性に優れた電解銅箔、並びにその製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明は、銅を主成分とし、メルカプト基を持つ化合物並びにそれ以外の少なくとも1種以上の有機化合物及び塩化物イオンを添加した電気分解液を用いた電気分解で作成された、銅箔表面の一部がコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ の凹凸表面を有することを特徴とする電解銅箔である。

また、本発明の電解銅箔はその樹脂基板との被接着面のコブ状突起からなる表面粗度が $2 \sim 4 \mu\text{m}$ である未処理銅箔の該被接着面上に電気分解浴中で所定電流を所定時間付加する粗化処理を施してなる電解銅箔である。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号 特願 2003-033159
受付番号 50300214930
書類名 特許願
担当官 第六担当上席 0095
作成日 平成15年 5月 6日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 2月12日
【特許出願人】 申請人
【識別番号】 300062979
【住所又は居所】 神奈川県横浜市西区岡野2丁目4番3号
【氏名又は名称】 古河テクノリサーチ株式会社
【特許出願人】
【識別番号】 591056710
【住所又は居所】 東京都千代田区神田錦町1丁目8番地9
【氏名又は名称】 古河サーキットフォイル株式会社

次頁無

特願2003-033159

出願人履歴情報

識別番号 [300062979]

1. 変更年月日 2000年 8月10日
[変更理由] 新規登録
住 所 神奈川県横浜市西区岡野2丁目4番3号
氏 名 古河テクノリサーチ株式会社

特願 2003-033159

出願人履歴情報

識別番号 [591056710]

1. 変更年月日 1991年 3月 1日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田錦町1丁目8番地9
氏 名 古河サーキットフォイル株式会社